

1. Record Nr.	UNICAMPANIAVAN0126018
Titolo	Die-Attach Materials for High Temperature Applications in Microelectronics Packaging : Materials, Processes, Equipment, and Reliability / Kim S. Siow editor
Pubbl/distr/stampa	Cham, : Springer, 2019
Descrizione fisica	XX, 279 p. : ill. ; 24 cm
Disciplina	621.36 620.11 620.1 658.4 669 621.381
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia